

证券代码：688693

证券简称：锆威特

苏州锆威特半导体股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会)

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 24 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 丁国华 董事、总经理 罗寅 独立董事 秦舒 董事会秘书 严泓 财务总监 刘娟娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.今年一季度亏损的原因是什么？展望二季度的经营情况？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！一季度受市场环境、产品结构优化及客户筛选调整等因素影响，短期内销售有所下滑；此外研发投入增大及库存减值增加，导致一季度利润减少。公司将持续做好经营管理，强化企业核心竞争力，提升企业内在价值，致力于为股东创造可持续回报。感谢您的关注！</p> <p>2.公司上市第一年业绩就下滑，一季度更亏损，上市前业绩是否是人为调节，为了高价发行，今年是否会全年亏损。</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司上市期间尚处于行业景气区间，受宏观经济、行业周期及市场环境等因素影响，公司业绩出现了一定程度的下滑。公司将持续做好经营管理，强化企业核心竞争力，提升企业内在价值，致力于为股东创造可持续回报。感谢您的关注！</p>

3.公司在 2023 年度的营业收入和净利润下降原因是什么

答:尊敬的投资者,您好!一方面,2023 年度受宏观经济环境、地缘政治变局、行业周期等不利因素影响,公司所处的功率半导体市场处于周期较低区间,终端市场需求不及预期。另一方面,2023 年度,公司期间费用占营业收入的比例较上年度有所提升,主要原因是公司持续加大产品研发投入,针对高可靠、新能源、储能、智能电网等重点应用领域进行产品研发,同时加大市场布局和产品推广,经营性费用有所增加。感谢您的关注!

4.公司 2023 年的业绩受到宏观经济环境、行业周期等因素的影响而出现下滑。请问公司将采取哪些具体措施来应对这些外部挑战,并恢复业绩增长?

答:尊敬的投资者,您好!在当前复杂严峻的环境下,公司将采取以下措施来积极应对挑战。首先,坚持稳健经营,持续推动技术创新和产品研发,不断提升产品的质量和性能,以满足客户的多样性需求。其次,持续加强市场拓展力度,积极开展客户开发、渠道建设、市场开拓等工作,通过深入了解市场需求情况,制定有针对性的营销策略,加强与客户和合作伙伴的沟通和合作,不断提升核心竞争力,推动经营业绩的持续改善。感谢您的关注!

5.公司在 2023 年度的研发费用投入是多少,2024 预计投入情况

答:尊敬的投资者,您好!公司 2023 年度研发费用为 3,602.11 万元,同比增长 58.55%。公司深耕功率半导体领域多年,具备较强设计与研发能力,核心技术突出,产品矩阵日益丰富。2024 年,公司将持续加大研发投入,加强对核心技术的积累,在注重基础研究的同时,深度拓展前沿技术的应用,推动产品的技术高效升级与产业化进程,以增强产品竞争力。感谢您的关注!

6.公司未来在研发方面的重点方向是什么?是否有计划推出新的产品线或技术以保持市场竞争力?

答:尊敬的投资者,您好!公司将继续专注于功率半导体的设计、研发与销售,主要围绕工业控制、高可靠及消费电子领域,在新能源汽车、光伏能源、轨道交通、智能电网等细分应用展开布局;在目前掌握的核心技术基础上,展开产品系列化及下游市场的进一步拓展、延伸。感谢您的关注!

7.公司的核心竞争力主要体现在哪些方面?

答:尊敬的投资者,您好!经过多年的技术沉淀和创新发展,公司已同时具备功率器件和功率 IC 的设计、研发能力,积累了多项具有原创性和先进性的核心技术,依托上述核心技术有效提升了公司产品性能指标,增强了产品市场竞争力。公司现已逐步形成了稳定且不断拓展的优质客户群体、较强的研发和技术创新能力、快速反应的订单交付能力、过硬的产品质量和完善的质量管理体系以及在第三代半导体领域的先发优势等核心竞争力。感谢您的关注!

8.公司在未来发展面临的主要风险有哪些？

答:尊敬的投资者，您好！公司未来面临的主要风险请详见已披露的2023年年度报告。感谢您的关注！

9.公司是否有计划拓展新的市场领域或行业，以实现客户基础的多元化？

答:尊敬的投资者，您好！公司将针对高可靠、新能源、储能、智能电网等重点应用领域持续加大产品研发投入，积极开展相关产品业务的客户开发、渠道建设、市场开拓等工作，不断提升核心竞争力。感谢您的关注！

10.公司如何定位自身在行业中的地位，并把握行业发展的机遇？

答:尊敬的投资者，您好！功率 MOSFET 方面，公司凭借性能好、可靠性高的产品积累了众多业内知名的芯片设计公司客户及高可靠领域的模块电源客户，产品已被诸多知名终端客户以及高可靠领域电源龙头企业、国家重点科研院所采用。在细分领域，公司的产品性能参数处于业内先进水平，具有较强的市场竞争力。SiC 功率器件方面，公司是国内为数不多的具备 650V-1700V SiC MOSFET 设计能力的企业之一，产品已覆盖业内主流电压段。功率 IC 方面，公司功率 IC 对标行业先进厂商，产品关键指标已达到行业先进厂商对标产品的水平，实现了国产替代，确保自主可控。公司在高可靠领域已取得一定的市场地位。公司将持续做好经营管理，强化企业核心竞争力，提升企业内在价值。感谢您的关注！

11.公司是否享受了某些税收优惠政策，这些政策对公司的财务状况有何影响？

答:尊敬的投资者，您好！公司是国家级高新技术企业、国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，相关税收优惠政策请详见已披露的2023年年度报告。感谢您的关注！

12.面对业绩下滑和技术泄密等风险，公司将如何加强风险管理和内部控制体系，以保护公司和股东的利益？

答:尊敬的投资者，您好！公司高度重视保护投资者尤其是中小投资者的利益，始终把完善公司治理结构、健全内部控制制度等作为公司投资者权益保护的重要举措，公司将持续做好经营管理，提升企业内在价值，努力提升应对风险的能力。感谢您的关注！

13.公司采用 Fabless 模式，晶圆制造和封测环节依赖外部供应商，公司将如何确保供应链的稳定性，以应对可能的市场波动和产能限制？

答:尊敬的投资者，您好！目前公司已与国内知名晶圆制造厂商及封测厂商形成了长期合作关系，建立了较为稳定的晶圆制造、封装和测试的供应渠道，具有完善的外协供应商管理体系，对主要晶圆制造厂商及封测厂商均进行有效管理，以保证供应产品的质量符合要求以及卓有成效地完成客户的产品交付。感谢您的关注！

	<p>14.sic 进展如何?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司自2018年下半年开始研发SiC功率器件,积极布局第三代半导体,通过对SiC功率器件的结构设计和生产工艺进行不断探索和研发投入, SiC功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段。2023年度,公司加大SiC MOSFET加工的产能布局及工艺平台的开发, 1200V SiC MOSFET工艺平台已成功进入中试阶段。感谢您的关注!</p> <p>15.公司一季度亏损,是否现产品前景不好,公司产品是否要升级换代</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!一季度受市场环境影响,短期内销售有所下滑;此外研发投入增大及库存减值增加,导致一季度利润减少。公司始终关注行业技术发展动态,结合积累的研发经验和技術优势,围绕客户的需求开展产品研发工作。感谢您的关注!</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年05月24日